



# 8704

## 제품 정보

100µm 반응성 마운팅 테이프

### 제품 설명

tesa® XPU 8704 큐어링 과정을 거쳐 접착 강도와 탄성이 높은 heat & pressure 반응성 마운팅 테이프.

IEC 61249-2-2-21에 따라 할로겐프리 제품으로 현재 RoHS 규정을 준수.

tesa® XPU 8704는 조립 과정에서 가해지는 열과 압력에 반응하여 접착된다.

### 특성:

- Extremely high bonding performance and reliability, even on thin design gaps
- Excellent shock resistance
- Extremely low oozing ratio
- Translucent design

### 특성

- At room temperature tesa® XPU 8704 is not tacky.
- It is activated by heat and pressure applied during the assembly process.
- tesa® XPU 8704 is free of halogen according to IEC 61249-2-21 and compliant with current RoHS directive.
- Extremely high bonding performance and reliability, even on thin design gaps
- Extremely low oozing ratio
- Translucent design
- Excellent shock resistance

### Applications

tesa® XPU 8704 적용 권장 :

- Bonding of plastics
- Bonding of metals
- Bonding of electronic components

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08704>

# 8704

## 제품 정보

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### 제품 구조

• 기재 소재	없음	• 총두께	100 µm
• 점착제 종류	crosslinkable polyurethane	• 컬러	반투명
• 이형지 종류	PE 코팅된 직물		

#### 속성 / 성능 값

• 점착력 (푸쉬 아웃)	4 N/mm <sup>2</sup>
---------------	---------------------

#### 추가정보

Technical recommendations: 기술적 정보

tesa® XPU 8704 is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for bond line parameters to start with.

#### 1. Pre-lamination:

During pre-lamination, laminate the adhesive tape onto the first component.

Setting:

- Temperature<sup>1</sup> 55-65 °C
- Pressure<sup>2</sup> 3 bar
- Time 5 – 20 s

Short-time exposure to 65 °C bond line temperature during pre-lamination does not impact final bonding potential.

#### 2. Bonding:

Remove the liner from tape after the pre-lamination step.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08704>



# 8704

## 제품 정보

### 추가정보

Position the second component. Apply temperature and pressure for the bonding time to reach sufficient bonding strength.

#### 2.1. PC/PC:

Setting:

- Temperature<sup>1</sup> 80 – 140 °C
- Pressure<sup>2</sup> 5 bar
- Time 10 – 120 s

#### 2.2. AL/PC:

Setting:

- Temperature<sup>1</sup> 110 – 190 °C
- Pressure<sup>2</sup> 5 bar
- Time 20 – 120 s

Short cycle times can be achieved at high bond line temperatures. For activation at low temperatures, increase the heat-press time. To reach maximum bonding strength, surfaces should be clean and dry. Allow at least 1-2 hours dwell-time after bonding before performance testing. Final bonding strength will be reached after 24 hours.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions.

(PC/PC: bonding conditions: temperature = 110 °C (120°C jig); pressure = 5 bar; time = 60 sec / AL/PC: bonding conditions: temperature = 170 °C (180°C jig); pressure = 5 bar; time = 20 sec.)

Storage: tesa® recommends storage in original packaging in cool and dry conditions.

<sup>1</sup> 'Pre-lamination' and 'Bonding' temperature refer to the data that is measured in the bond line.

<sup>2</sup> 'Pre-lamination' and 'Bonding' pressure refer to the force that is transferred from jig surface directly to the bonding area.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08704>



# 8704

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08704>